

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访</p> <p><input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会</p> <p><input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>【华安证券股份有限公司】：汤宏伟</p> <p>【深圳市瀚鑫私募证券投资基金管理有限公司】：谢立堪</p> <p>【广东致道私募证券投资管理有限责任公司】：林志诚</p> <p>【广东华骏私募基金管理有限公司】：钟伟强</p> <p>【珠海巨石私募基金管理有限公司】：黄锦兰，钟旭东</p>
<p>时间</p>	<p>2026年6月15日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>【主讲人】：</p> <p>卢海航 董事、董事会秘书、财务负责人</p> <p>吴昊晟 高级投关经理</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q：请问公司产能状态如何？是否存在供不应求情形？如何保证产能交付？</p> <p>A：公司采用 Fabless 经营模式，晶圆代工及封测均委托第三方合作伙伴完成。目前成熟制程 8 英寸产能整体处于供</p>

需偏紧状态，公司通过与境内外主流晶圆厂、封测厂建立长期战略合作关系，并执行"国内+国际"双循环供应链策略，供应商资源储备充裕，目前整体产能可匹配下游订单需求，不存在重大交付瓶颈，能够保障客户的交付要求。

Q: 请问诚芯微预计 2026 年能给公司带来多少收入和利润增量？

A: 公司已于 2026 年 3 月完成诚芯微 100%股权交割，自 2026 年第二季度起将其纳入合并报表范围。交易对方承诺，诚芯微 2025 年-2027 年经审计归母净利润（扣非前后孰低）分别不低于 2,200 万元、2,500 万元、2,800 万元，三年累计不低于 7,500 万元。诚芯微 2025 年度已实现净利润 2,261.85 万元，业绩承诺实际完成率为 102.81%，2026 年业绩完成情况请以公司后续定期报告披露为准。

Q: 请问公司 2026 年各项费用支出计划，费用率能否持续下行？

A: 随着公司营收规模持续扩张，经营杠杆逐步显现，2026 年一季度，公司期间费用率已同比显著下降。后续公司将持续保持研发投入强度，以支撑消费、车规及 AI 算力等新品开发，销售费用与管理费用则严控增幅，期望在中长期期间费用率将随收入规模增长而下降。

Q: 请问公司今年 2 月产品涨价落地情况？

A: 受上游晶圆代工及封测环节成本上行影响，公司自 2026 年 3 月 1 日起，对部分盈利承压的消费电子及车载产品线实施差异化价格调整。本次调价主要覆盖新增订单，存量订单仍按原合同执行。目前价格传导顺畅，公司将持续跟踪上游成本走势，动态优化定价策略，以保障业务盈利水

	<p>平与供应链韧性。</p> <p>Q: 请问公司目前各产品线的毛利率情况如何?</p> <p>A: 公司 2025 年综合毛利率约 30%，其中电源管理芯片毛利率为 43%，端口保护及信号切换芯片约 34%，音圈马达驱动芯片约 21%，传感器芯片及其解决方案约 17%。2026 年一季度，公司综合毛利率约 29%，随高毛利新品占比提升和诚芯微纳入合并报表，后续综合毛利率有望得到修复。</p> <p>Q: 请问公司目前 AI 算力电源芯片的进展情况?</p> <p>A: 在 AI 算力领域，公司依托深厚的技术积累，已完成面向 PC 及服务器 CPU/GPU 核心供电的大电流 POL 电源芯片布局：10-20A POL 产品已实现多家头部客户软硬件适配，部分客户在今年第二季度已实现量产；20-50A POL 芯片及配套功率模组已推出工程样品，正与目标客户开展系统级联调验证，后续将随客户需求节奏推进商业化落地。</p> <p>在 AI 端侧领域，公司为 AI 手机、AI 眼镜等终端设备提供高精度、低功耗电源管理方案，相关产品已导入雷鸟、亿境、夸克等国内头部品牌，以及 Meta 等国际大厂供应链。此外，公司与高通达成长期战略合作，作为高通主芯片参考设计的优选电源管理供应商，进一步强化了公司在 AI 端侧市场的竞争壁垒与客户粘性。</p> <p>Q: 请问公司与高通参考设计合作的产品落地节奏?</p> <p>A: 公司与全球主芯片厂商高通（Qualcomm）保持着长期深度战略合作。在电源管理与端口保护及信号切换领域，公司多款芯片产品已成功通过高通多个平台的参考设计认证并已实现出货，广泛应用于智能手机、笔记本电脑、AR/VR/MR 智能穿戴终端及智能汽车等高增长市场。</p>
--	--

	<p>Q: 请问公司车规业务的进展情况及放量节奏?</p> <p>A: 公司车规级电源管理芯片产品已通过 AEC-Q100 认证, DC/DC 芯片进入高通汽车平台参考设计并向 Joynext、Yura Tech 等前装厂商批量出货, 最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等品牌。2025 年起, 公司车规业务同比增速较快, 目前营收占比仍持续上升; 2026 年公司新增多家头部新能源及传统车企平台化定点, 预计随相关车型项目陆续进入 SOP (量产启动) 阶段, 车规业务将步入持续放量期。</p> <p>Q: 请问公司后续研发的重点方向?</p> <p>A: 公司坚定贯彻“消费电子+汽车电子”双轮驱动战略, 持续深耕高端定制化电源管理芯片及信号链芯片领域; 同时, 积极布局 AI 算力与数据中心赛道, 大力拓展大电流供电芯片及功率模组产品, 打造第二增长曲线。</p> <p>Q: 请问公司应收账款及存货的周转情况?</p> <p>A: 公司 2026 年一季度应收账款周转天数在 2 个月以内, 存货周转天数在 5 个月以内, 符合 Fabless 芯片设计行业账期及备货特性。公司持续加强应收账款催收与库存管控, 结合销售预测动态调整备货水位, 近年存货减值风险已随需求回暖得到有效缓释, 整体周转状况保持健康。</p> <p>Q: 请问公司境外业务占比较高的原因?</p> <p>A: 公司早期即通过高通参考设计切入海外及国际品牌供应链, 电源管理芯片等产品已大规模应用于三星等全球头部消费电子厂商的终端产品, 该类客户主要采取境外主体下单结算, 同时通过香港及境外子公司开展海外业务运营</p>
--	---

	并归集相关收入。因此，公司营业收入中境外（含港澳台及海外）收入占比相对较高，系公司国际化客户结构与经销模式的正常体现。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月15日